経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく、半導体に係る安定供給確保取組方針（案）に対する意見公募について

令和８年５月 14 日
経済産業省商務情報政策局
情報産業課

令和８年３月６日から同年５月１日までの間、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく、半導体に係る安定供給確保取組方針（案）」について意見公募を実施しました。今般、提出いただいた主な御意見及び提出意見を考慮した結果を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

また、意見公募の終了後、所要の技術的修正を行いましたので、併せてお知らせいたします。

	提出いただいた主な御意見	提出意見を考慮した結果
1	本改定案について、半導体、製造装置、部素材、原材料まで含めて安定供給確保の対象を広く捉えている点は評価します。半導体の安定供給は、単なる産業政策ではなく、国民生活、基幹インフラ、防衛、医療、通信、輸送等を支える経済安全保障の根幹であり、特定の国・地域への過度な依存が我が国の重大な脆弱性となるとの問題意識には賛同します。 しかしながら、本改定案は全体として、供給途絶リスクへの認識は示しているものの、なお「国際分業を前提とした供給網の補強」の域を出ておらず、真に必要な「国家としての供給自立性の確立」という観点が弱いと考えます。半導体は一部の工程、部材、原料が欠けるだけで国内生産全体が停止し得る戦略物資であり、平時の効率性や企業売上高のみを重視する政策では不十分です。 特に、2030 年に向けた売上高目標は産業振興の指標としては理解できるものの、安定供給確保の観点からは、売上高よりも以下のような指標を政策の中心に据えるべきです。	半導体の安定供給確保に当たって、国内生産能力・代替可能性・技術や人材の維持等が重要であるとの御指摘について、今後の制度運用に当たって参考とさせていただきます。

	国内需要に対する供給充足率 重要工程・重要部素材・重要原料の国内代替可能率 有事・供給途絶時における継続稼働可能期間 特定国・特定地域への依存率低減の進捗 国内で保有・維持される製造技術、人材、知的財産の割合 また、国際連携それ自体を否定するものではありませんが、安定供給確保の名の下に、実質的に対外依存構造を温存又は再編するだけであってはならないと考えます。依存先が変わるだけでは、我が国の供給主権は回復しません。とりわけ、先端技術・基幹技術・製造ノウハウについては、共同研究や海外連携を進める場合でも、国家として流出させてはならない範囲を明確化し、国内保持を原則とすべきです。 そのため、以下の点を取組方針により明確に位置付けることを求めます。 重要半導体、重要部素材、重要原材料について、国内生産能力・国内代替能力の維持拡大を明示的目標とすること 補助金、認定、支援措置について、国内立地のみならず、国内雇用、国内技術保持、国内知財管理、国内サプライヤー育成を要件として強化すること 原材料について、輸入確保だけでなく、国内回収、再資源化、備蓄、代替材料開発を中核政策として位置付けること 重要品目ごとに、依存度、代替性、備蓄水準、途絶時影響を継続的に公表・点検すること 「市場に委ねた結果としての脆弱化」を是正する観点から、平時の効率性よ	

	りも非常時の継続性を重視した政策評価へ転換すること 半導体は、輸出産業として育成すれば足りるものではなく、国家の基盤機能を維持するために国内で制御可能でなければならない重要物資です。したがって、本改定案は、単なる供給網の強靱化ではなく、我が国の技術・生産・原料確保の主権を回復する方針として、より踏み込んだ記述へ修正されるべきと考えます。 以上です。	
2	化学産業として、半導体製造を支える上流原料や関連部素材は、サプライチェーン全体の安定性確保に不可欠な要素であると認識している。これらの原料・部素材についても支援対象に含められるよう、支援範囲・定義または認定基準など、支援対象を判断する際の基本的な考え方を明確にしたうえで、支援の拡充を検討いただきたい。 理由： 改定案にも記載の通り、半導体の原料および部素材は製造における重要な構成要素であり、一つでも欠ければ、供給途絶リスクが高まる。化学産業はこれらの原料・部素材を多く供給しており、世界的シェアを有するものも少なくない。 本改定案の半導体支援の対象として ・半導体製造装置及び半導体製造装置を構成する部品・素材等 ・半導体部素材及び半導体部素材を構成する部品・素材等 ・半導体原料（黄リン・黄リン誘導品、ヘリウム、希ガス、蛍石・蛍石誘導品） とあるが、半導体の製造には、フォトレジスト、ビルドアップフィルム、保	半導体の安定供給確保に当たり、製造を支える部素材・原材料やその上流原料が重要であるとの御指摘について、承りました。 本取組方針案においても、半導体部素材・原料等を含めたサプライチェーン全体の強靱化を図ることとしており、個別の支援対象については、供給途絶リスクや代替困難性等を踏まえて判断してまいります。

	護テープなど多様な部素材が不可欠であり、さらにそれらを生産するための樹脂原料など、より上流の化学品も重要な役割を果たしている。これらの素材群は、半導体製造におけるサプライチェーン全体の安定性を左右するものであり、経済安全保障の観点からも支援対象として位置づけるべき重要な構成要素である。 本方針案に基づく支援は、経済安全保障推進法に基づく供給確保計画の認定制度を前提とした運用により引き続き認定された部素材などに対しても支援されると想定される。その上で、日本の戦略分野の中核である半導体産業の競争力強化とサプライチェーンの強靭化のため、直接的な部素材・原料はもとより、関連部品・素材や上流原料についても支援が行き届くよう、支援範囲・定義または認定基準など、部素材・原料に関する支援対象を判断する際の基本的な考え方を明確にしたうえで支援の拡充を検討いただきたい。	
3	本取組方針が、半導体の安定供給確保を「経済安全保障」の観点から位置づけ、半導体製品のみならず、製造装置、部素材、原料までを含むサプライチェーン全体を支援対象として整理している点について、強く賛同する。 特に、半導体部素材については、品質差やプロセス適合性により代替が極めて困難であり、供給途絶が発生した場合、半導体製造全体に即時かつ深刻な影響を及ぼす点が本取組方針において適切に認識されていると考える。 一方で、現行案におけるサプライチェーン強靭化に向けた支援の枠組みは、主として量産段階における生産設備投資を想定した記載が中心となっている。 しかしながら、半導体部素材分野においては、将来の安定供給確保および技	半導体部素材分野において、研究開発・評価実証設備等への投資が将来の安定供給や技術基盤の維持に重要であるとの御指摘について、今後の施策の検討・運用の参考とさせていただきます。

	術的自立性は、量産設備投資よりも前段階にある研究開発・評価・実証フェーズにおける投資の成否によって左右されるという構造的特徴がある。 具体的には、 1. 次世代半導体プロセスに対応する材料の研究開発 2. 実機評価・顧客プロセス擦り合わせを行うための研究開発施設・パイロット設備 3. 原料制約・地政学リスクを前提とした代替材料・基盤技術の研究開発 といった取組が、将来の量産移行および国内供給の安定性を決定づける重要な要素となっている。 これらの研究開発拠点が海外に集中または流出した場合、将来的に日本国内に量産設備を整備したとしても、 1. 中核技術の日本国外への依存 2. 技術流出リスクの増大 3. 有事における迅速な供給回復の困難化 といった問題が生じ、我が国の経済安全保障上の不可欠性、自律性の確保に深刻な影響を与える事となる。 以上を踏まえると、半導体部素材分野における研究開発施設・評価実証設備への投資は、量産設備投資と一体のものとして、経済安全保障上の安定供給確保に直接資する取組と位置づけることが合理的である。 したがって、サプライチェーン強靭化を目的とする補助・支援措置においては、 量産設備への投資に加え、将来の安定供給確保・技術自立性確保に資する研究開発施設・実証設備への投資についても、明確に支援対象として位置づけることを要望する。 これにより、本取組方針が目指す半導体および関連部素材の安定供給確保	

	が、短期的対応にとどまらず、中長期的かつ持続的に実効性を有するものになると考える。	

以上